





## 安全评价报告信息公开表格（浙江惠丰电子有限公司）

被评价单位名称		浙江惠丰电子有限公司
评价项目名称/项目编号		浙江惠丰电子有限公司电子材料芯片及核心组件建设项目安全预评价/道字【评】字第2206005号
项目简介（含图片）		<p>浙江惠丰电子有限公司于2021年07月07日注册成立，位于浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区，法定代表人：田德辉，注册资本：壹仟万元整，统一社会信用代码：91330522MA2JKAP547。电子材料芯片及核心组件建设项目为无锡市惠丰电子有限公司与长兴县小浦镇人民政府合作，由无锡市惠丰电子有限公司投资建设并成立浙江惠丰电子有限公司。本项目拟选址于浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区，新增工业用地33亩，建造厂房及辅助设施用房35023.28平方米，购置球磨机、搅拌磨、压机、抛光机、测试仪等生产及辅助设备212台，项目总投资32800万元。项目投产后，将形成年产陶瓷芯片8000万件、传感器及换能器2000万只的生产能力。</p>
		 
		 
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		姚敏杰
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		赵颖斌
评价报告编制人		姚敏杰
报告审核人		张奇峰
参与评价工作	安全评价师	姚敏杰、胡攀
	注册安全工程师	姚敏杰、胡攀
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	姚敏杰、胡攀
	时间	2022.06.16-2022.08.21
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.08.21